

# 平面サンプルの表層採取に！

表面・界面 物性解析装置

# SAICAS

Surface And Interfacial Cutting Analysis System

## X電動ステージ付モデル

## EN-WA型

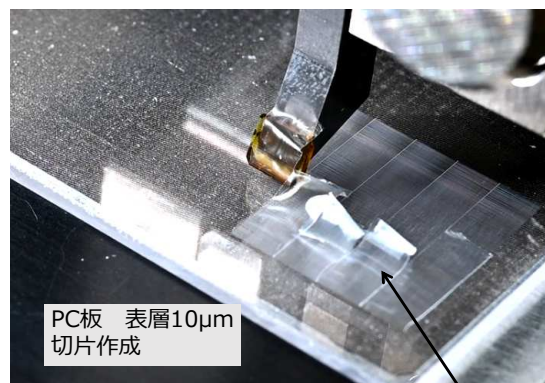
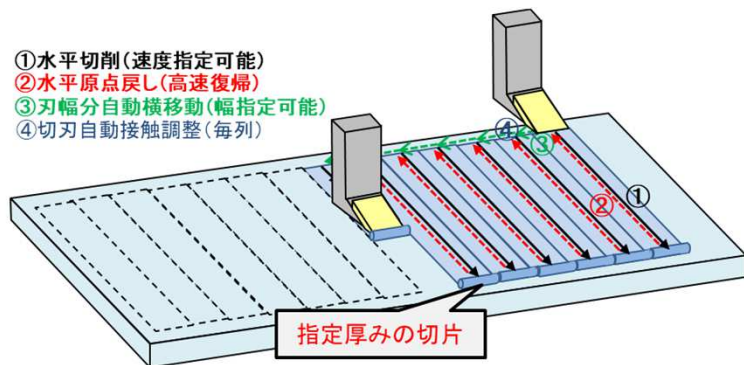
### 専用機能「水平連続切削」



ミクロトームでは難しい  
平面サンプルの表層採取前処理を  
誰でも・簡単に・自動的に実現

## X電動ステージで一例ずつ横へ自動切削

- ①水平切削(速度指定可能)
- ②水平原点戻し(高速復帰)
- ③刃幅分自動横移動(幅指定可能)
- ④切刃自動接触調整(毎列)

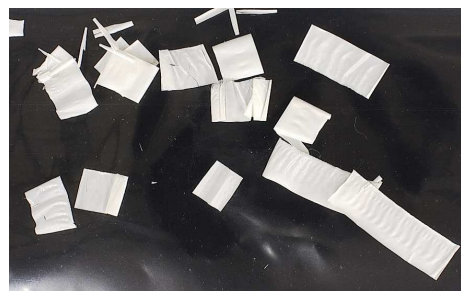
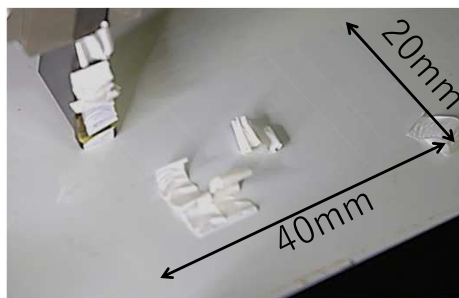


切片を湿式分析や熱分析に活用

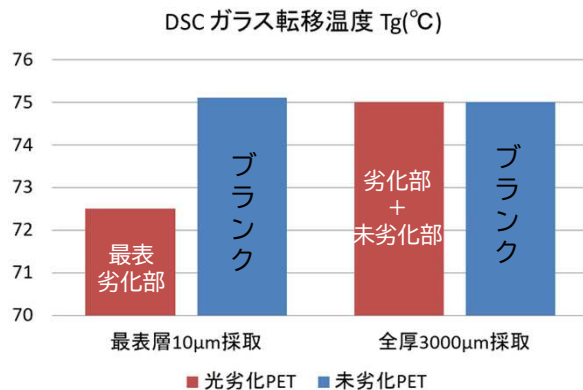
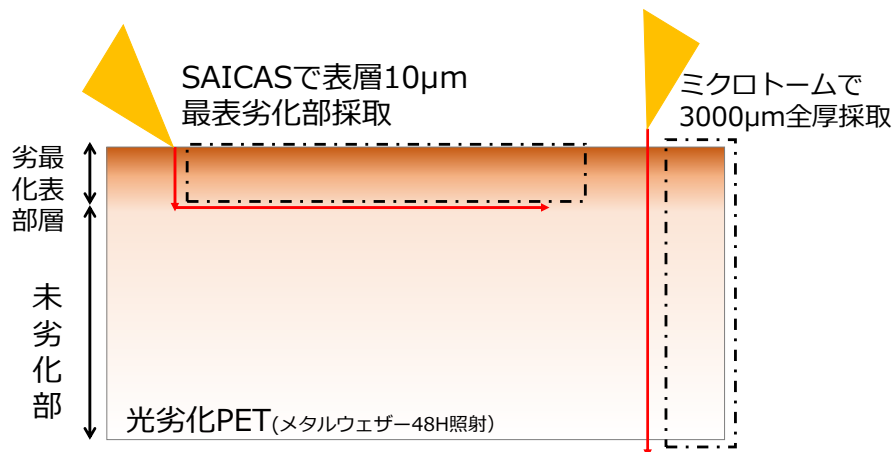
## [採取事例]ウレタン系塗膜の10μm表層採取

切削深さ 10μm  
切削面積 20mm×40mm

切削時間 30分程度  
採取切片重量 8mg程度



## [分析活用事例]光劣化PET板の10μm表層採取→DSC測定



最表面層劣化部のみを採取することで  
ガラス転移温度の低下を検知